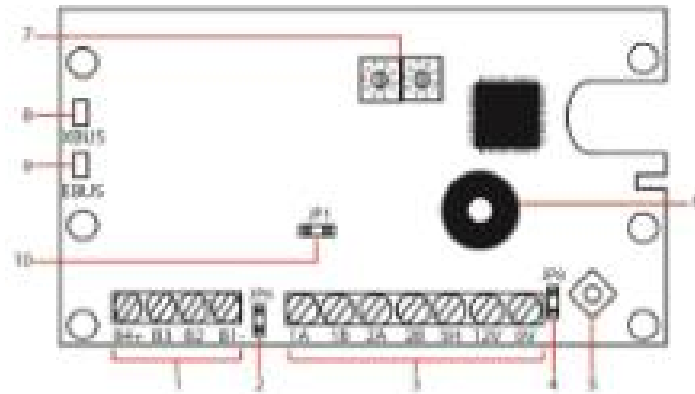


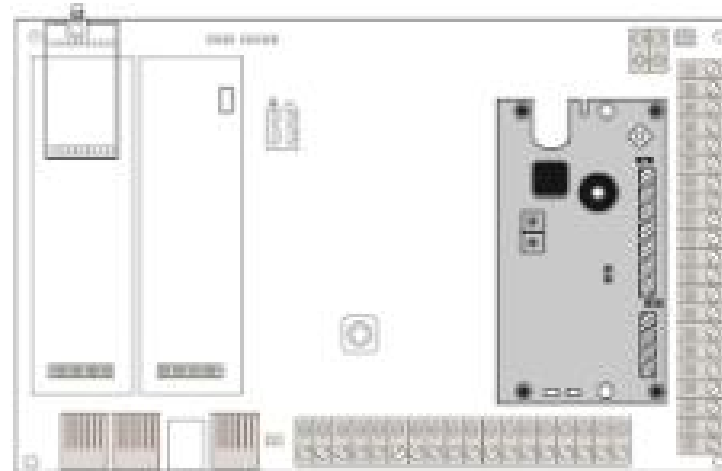
SPCG310

Bramka (gateway) magistrali E-BUS systemu SPC (pl)

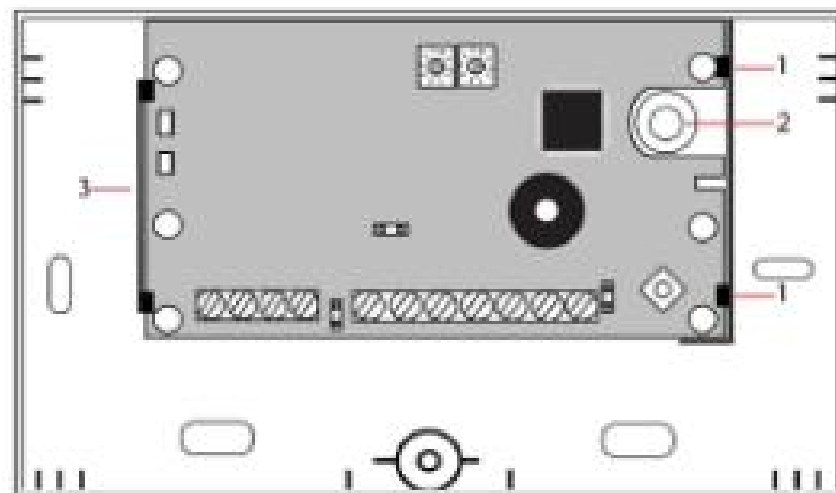
1



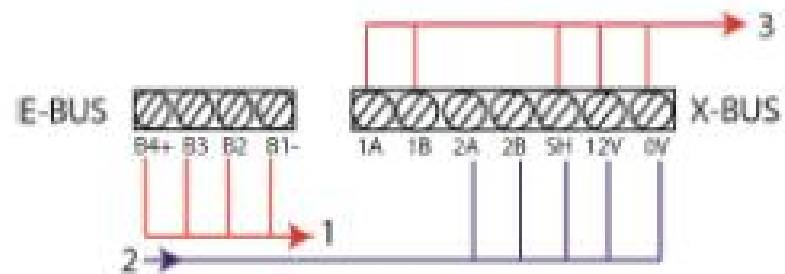
2



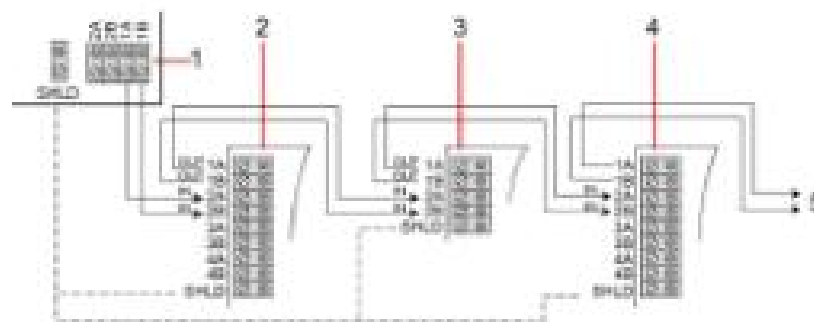
3



4



5



Instrukcja (polski)

Podczas wymiany lub montażu SPCP355 w systemie SPC należy w każdym wypadku odłączyć zasilanie sieciowe i akumulatorowe. Przy obchodzeniu się ze złączami, przewodami, zaciskami i obwodami drukowanymi należy stosować się do zaleceń bezpieczeństwa związanych z ochroną antystatyczną.

Deklaracja zgodności WE

Siemens Security Products niniejszym oświadcza, że produkt ten spełnia podstawowe wymagania i inne odpowiednie przepisy dyrektywy 2004/108/WE o kompatybilności elektromagnetycznej (EMC).

Deklaracja zgodności jest dostępna w najbliższym biurze handlowym firmy Siemens lub:

Siemens AB, Security Products

Englundavagen 7

SE-171 24 Solna

Szwecja

Wprowadzanie do bramki (gateway) magistrali E-BUS systemu SPC (SPCG310)

Bramka magistrali E-BUS systemu SPC (SPCG310) jest modułem rozszerzenia magistrali X-BUS, umożliwiającym komunikację między sterownikiem SPC a urządzeniami magistrali E-BUS systemu Sintony.



Przed zainstalowaniem tego urządzenia Siemens zaleca zapoznanie się z dokumentem *Sintony System Migration (Migracja do systemu Sintony)*.

Przegląd produktu

Rys. 1: Karta SPCG310

1	Zaciski magistrali E-BUS
2	Zworka złącza zasilania magistrali X-BUS/E-BUS (JP6)
3	Zaciski magistrali X-BUS
4	Zworka obejścia zabezpieczenia antysabotażowego (JP8)
5	Przełącznik antysabotażowy
6	Sygnalizator dźwiękowy. Wykorzystywany do lokalizacji urządzenia i do adresowania urządzeń magistrali E-BUS.
7	Przełączniki adresów magistrali X-BUS
8	Dioda sygnalizacyjna LED magistrali X-BUS. Więcej informacji w pkt „Funkcje diody LED”
9	Dioda sygnalizacyjna LED magistrali E-BUS. Więcej informacji w pkt „Funkcje diody LED”
10	Zworka zakończenia magistrali X-BUS (JP1)

Instalowanie bramki SPCG310

Bramka SPCG310 może być zainstalowana w:

- sterowniku SPC
- obudowie SAH 14
- zasilaczu SAP 08/14/20/25

Instalowanie SPCG310 na sterowniku SPC

Zamontować SPCG310 jak na rys. 2 przy użyciu dostarczonych słupków montażowych.

Instalowanie SPCG310 w obudowie SAH 14

Wariant ten stosuje się przy wymianie bramki magistrali E-BUS systemu Sintony (SMG 91) na bramkę magistrali E-BUS systemu SPC (SPCG310).

Rys. 3: SPCG310 w obudowie

1	Zapinka
2	Otwór do wybicia na śrubę styku tylnego zabezpieczenia antysabotażowego.
3	Zapinka

Aby zainstalować SPCG310 w obudowie SAH 14, należy wykonać następujące czynności:

1. Wyjąć płytkę SMG 91 z obudowy SAH 14.
2. Włożyć brzeg SPCG310 pod zapinki (rys. 3, poz. 1).
3. Wsunąć SPCG310 z lewej strony do momentu uchwycenia płytki przez zapinkę (rys. 3, poz. 3).

Zworki

Zworka	Założona	Nie założona
JP1	Zworka zakończenia magistrali X-BUS — zworka ta musi być zawsze założona.	
JP6	Odcinek magistrali E-BUS zasilany z tego samego źródła, co SPCG310	Urządzenie zasilane przez magistralę E-BUS, niezależne od SPCG310.
JP8	Zabezpieczenie antysabotażowe wyłączone. Założyć w przypadku zamontowania na sterowniku SPC.	Zabezpieczenie antysabotażowe włączone. Nie zakładać w przypadku zamontowania w obudowie SAH 14.



Nie zakładać zworki na JP6 (rys. 1, poz. 2), jeśli zasilacz SAP jest podłączony do odcinka magistrali E-BUS.

Połączenie bramki SPCG310

Rys. 4: Połączenie bramki SPCG310

1	Pierwsze urządzenie na odcinku magistrali E-BUS
2	Z poprzedniego modułu rozszerzenia lub sterownika SPC
3	Do następnego modułu rozszerzenia lub sterownika SPC

Podłączanie interfejsu magistrali X-BUS:

Magistrala X-BUS umożliwia podłączenie modułów rozszerzenia i klawiatur do sterownika SPC. W zależności od wymagań instalacyjnych możliwych jest kilka różnych opcji konfiguracji podłączenia magistrali X-BUS.

Siemens zaleca połączenie bramki magistrali E-BUS systemu SPC w konfiguracji pętli. Konfiguracja multi-drop nie jest obsługiwana.

Uwaga: Maksymalna długość kabla systemowego = liczba modułów rozszerzenia i klawiatur w systemie x maksymalna odległość dla danego rodzaju kabla.

Rodzaj kabla	Odległość
Kabel alarmowy w standardzie CQR	200 m
Kategoria UTP: 5 (lity rdzeń)	400 m
Belden 9829	400 m
IYSTY 2 x 2 x 0.6 (min)	400 m

Rys. 5 przedstawia schemat podłączenia magistrali X-BUS do modułu rozszerzenia/sterownika i następnego modułu rozszerzenia/sterownika w układzie rozgałęźnym. Przy wykorzystaniu układu rozgałęźnego ostatni moduł rozszerzenia nie jest podłączany z powrotem do sterownika.

Rys. 5: Łączenie modułów rozszerzenia

1	Sterownik SPC
2	Poprzedni moduł rozszerzenia
3	SPCG310
4	Następny moduł rozszerzenia
5	W konfiguracji pętli zaciski 1A i 1B na ostatnim module rozszerzenia muszą być po odpowiednio z zaciskami 2A i 2B na sterowniku SPC.

Uwaga: W przypadku instalacji na sterowniku SPC należy pominąć poz. 2 i wykonać połączenie z poz. 1 do poz. 3.

Więcej informacji na temat okablowania, ekranowania, danych technicznych i ograniczeń znajduje się w *Podręczniku instalacji i konfiguracji SPC 42xx/43xx/52xx/53xx/63xx*.

Adresowanie

Adresowanie urządzeń magistrali E-BUS w systemie Sintony dopuszcza dublowanie adresów transponderów na różnych odcinkach magistrali E-BUS. Urządzenia magistrali X-BUS wymagają unikalnych adresów. Aby to zapewnić, może być wymagana zmiana adresów urządzeń peryferyjnych na magistrali E-BUS. Aby uzyskać więcej informacji o adresowaniu, patrz dokument *Sintony System Migration (Migracja do systemu Sintony)* lub *Instrukcja instalacji i konfiguracji systemu SPC 42xx/43xx/52xx/53xx/63xx*.

Funkcje diod LED

LED	Stan diody LED	Opis
Dioda sygnalizacyjna LED magistrali E-BUS (rys. 1, poz. 8) (miga tylko w trybie Pełnego Instalatora)	Regularne miganie (co ok. 1,5 sekundy.)	Stan komunikacji na magistrali X-BUS jest prawidłowy.
	Szybkie miganie (co ok. 0,2 sekundy)	Wskazuje problem między dwoma sąsiednimi modułami w konfiguracji pętli.
Dioda sygnalizacyjna LED magistrali E-BUS (rys. 1, poz. 9).	Szybkie miganie	Stan połączenia z magistralą X-BUS jest prawidłowy.
	Brak migania	Wskazuje problem w komunikacji na magistrali E-BUS.

Dane techniczne

Prąd roboczy	40 mA
Prąd spoczynkowy	40 mA
Napięcie robocze	9,5- 14 V DC
Wymiary (szer. x wys. x gł.)	92 mm x 52 mm x 13 mm
Masa	13 g
Temperatura pracy	-10 do +50 °C
Wilgotność względna	Maks. 90% (bez skraplania)
Interfejsy	X-BUS, E-BUS